

## FAQ

### (Acceleration of Methoxy Cure Materials)

- Q: 가 가 ? ,
- A: 가 , 60  
가  
가  
가 ( )  
가 가 가

### (Two-part Alkoxy Cure Mechanism)

- Q: 2 ?
- A: 2 가  
가 가  
가 가

### (Checking for Inhibition)

- Q: 가 가 ?
- A: 가  
Solder Flux

(Adhesion Problems with Heat Cure Materials)

Q:

A:

가  
가  
) , 가 (150  
, 가 , 125  
가  
, 가  
가  
가  
가  
가

Gel

(Inhibition in Gels)

Q: Potting Gel . 가 ?

A: 가 Gel 가 Gel Gel  
, 가  
Sylgard 170 . 170  
가 ,  
170 Gel .

Q: ?

A: / 가  
, 가 ( ), solder flexs,  
Solvent

Q: Primer , 가 ?

A: , 가  
Primer , 가  
가  
가 가

(Wetting and adhesion)

Q: primer ( )  
가 ?

A: coating 가  
/

가 ( ), solder flexs,

Solvent

Adhesion and substrate compatibility

Q: Primer

?

A: 가 , 가  
/

(Integral Oxide)

가

/

### Adhesion and electrical problems

Q: Primer가 ,  
, 가 가 ?

A: silicone 가 ( )  
가 , 110 C  
가 , ( )  
가 가 , 가  
DC

### (Thin coating and electrical failures)

Q: 가 1 mil  
가 ?

A: 가 가 가  
가 가 .  
가 3~5 mil .

Q: 1  
?

A: 10-911A-01

80% 24 72 90% 10 120

가

Q: 가 ( )

가 ?

A: 가 , 가 가 가

Burn-In

가

가

Q: 1 2 가

가 ?

A: 가 . 1  
( ) , 가 가 )  
(30%-80% 가 가 )  
가 .

Q: 가 ?

A: 가 ( )  
, , ,  
가 ,  
가 ,  
가

Q: 가 ?

A: 가  
가 ,  
가  
가  
가

가

Q: 가 ?

A: 가  
,

가

( Encapsulant Vs Potting)

Q: (Encapsulant), (Potting) (Potting material)  
?

A: 0.5-5cm

?

Q: 가 ?

A: 가

가

70~100C

5~30

가

가

125C

150C

가

(

가 )

가  
Heat sink